

O-leading PCB 製造 企業 紹介

O-Leading PCB 製造, PCB 製造 企業 PCB 製造 (PCBA) 企業 EMS 企業 企業 企業 企業 企業 HDI PCB, 企業 PCB, 企業-企業 PCB 企業 企業 PCB 企業 企業. 企業 企業 企業 企業 企業 企業 企業 企業 企業.

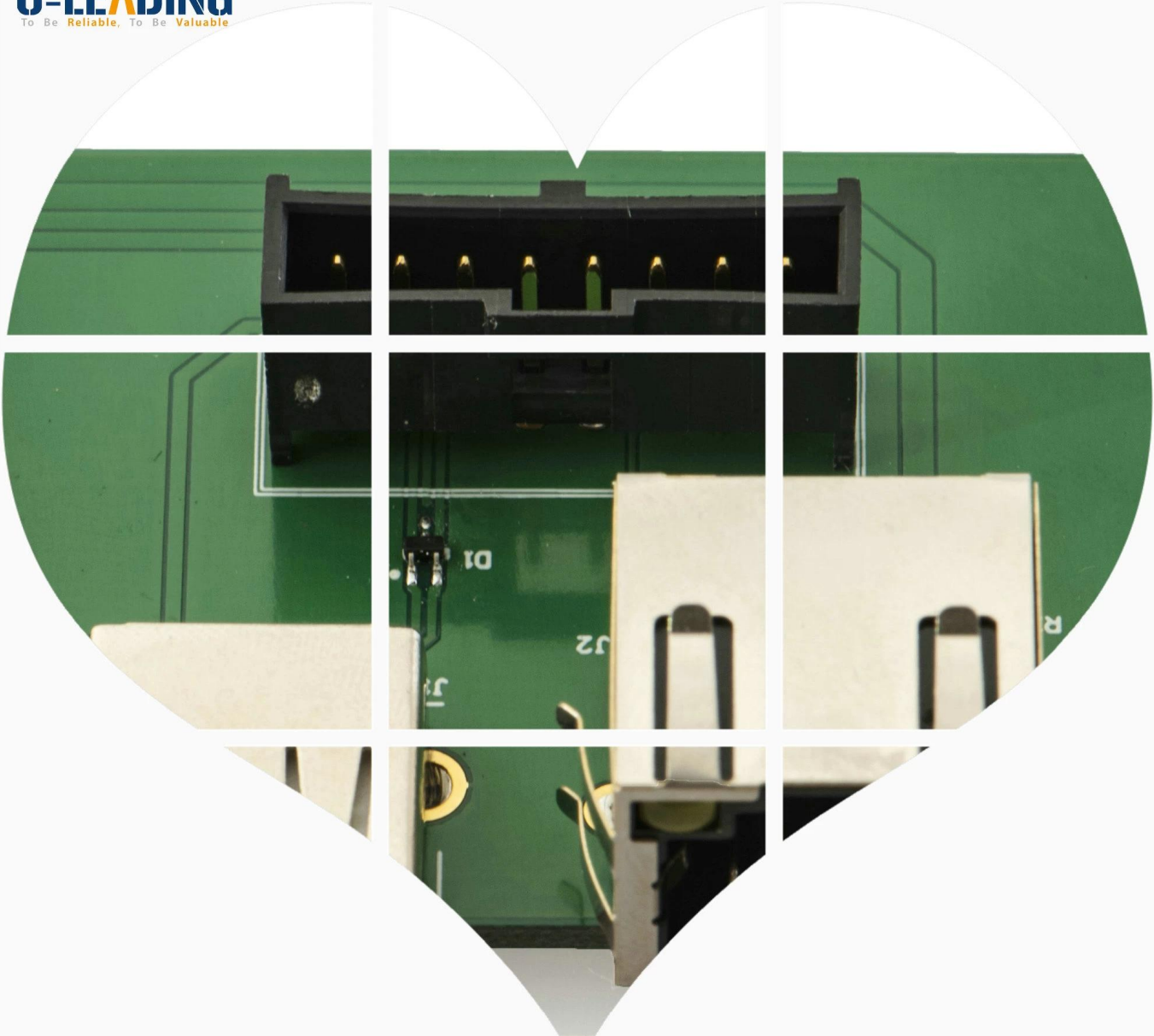
企業 企業 企業 企業, 企業 企業 企業 企業 企業 企業. 企業 企業 企業 企業 企業 企業 O 企業 企業 企業.

企業 O-leading 企業 企業 企業 企業 企業 企業, 企業 企業 企業 企業 企業 企業 PCB 企業 PCBA 企業 企業 企業 企業 企業 企業.

企業 企業 企業 企業. [企業 企業 企業 PCB 企業 企業](#)

企業 企業

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable



WE MAKE YOUR IDEA COME TRUE



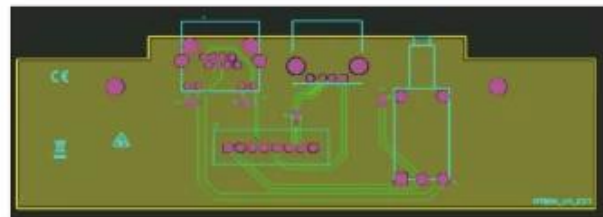
BOM

Manufacturer	Manufacturer Part Number	Designator (required)	Qty (required)	Description (required)
Molex	90136-1208	J1	1	Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 8 POS 2.54mm
Würth Elektronik	615008137421	J2	1	ular Jack WR-MJ, Tab Up, Shielded, with LED and EMI Panel Finger, Horizo
Panasonic	ERJ-3EKF5100V	R1,R2	2	Res Thick Film 0603 510 Ohm 1% 1/10W
Würth Elektroni	61400416021	J3	1	Conn USB 2.0 Type A F 4 POS Solder RA Thru-Hole 4 Terminal 1 Port Tray
Semtech	RCLAMP0502BATCT	D1	1	LAMP Series 25 V 1 pF SMT Uni/Bi-Directional TVS ESD/CDE Protection - SC
&K Componen	ELUMEETHQ6C22	S1	1	Switch Push Button ON ON SPDT Square Plunger 0.25A 50VDC 3.5VA

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

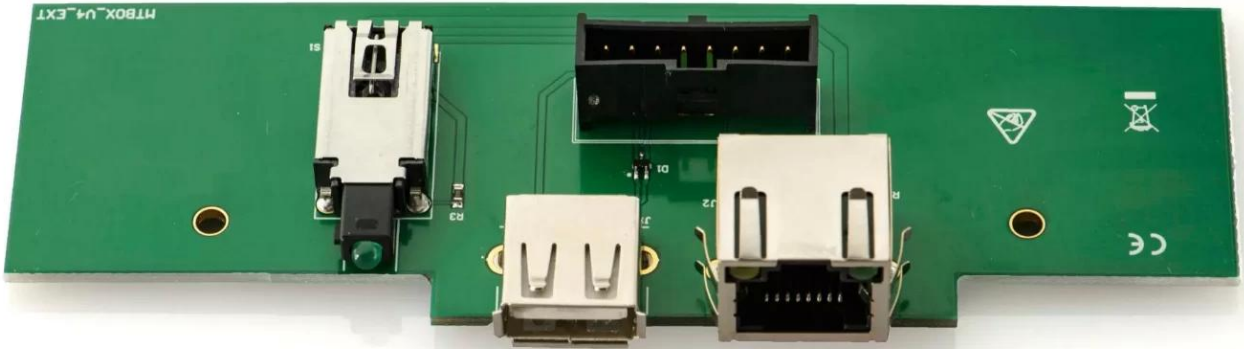
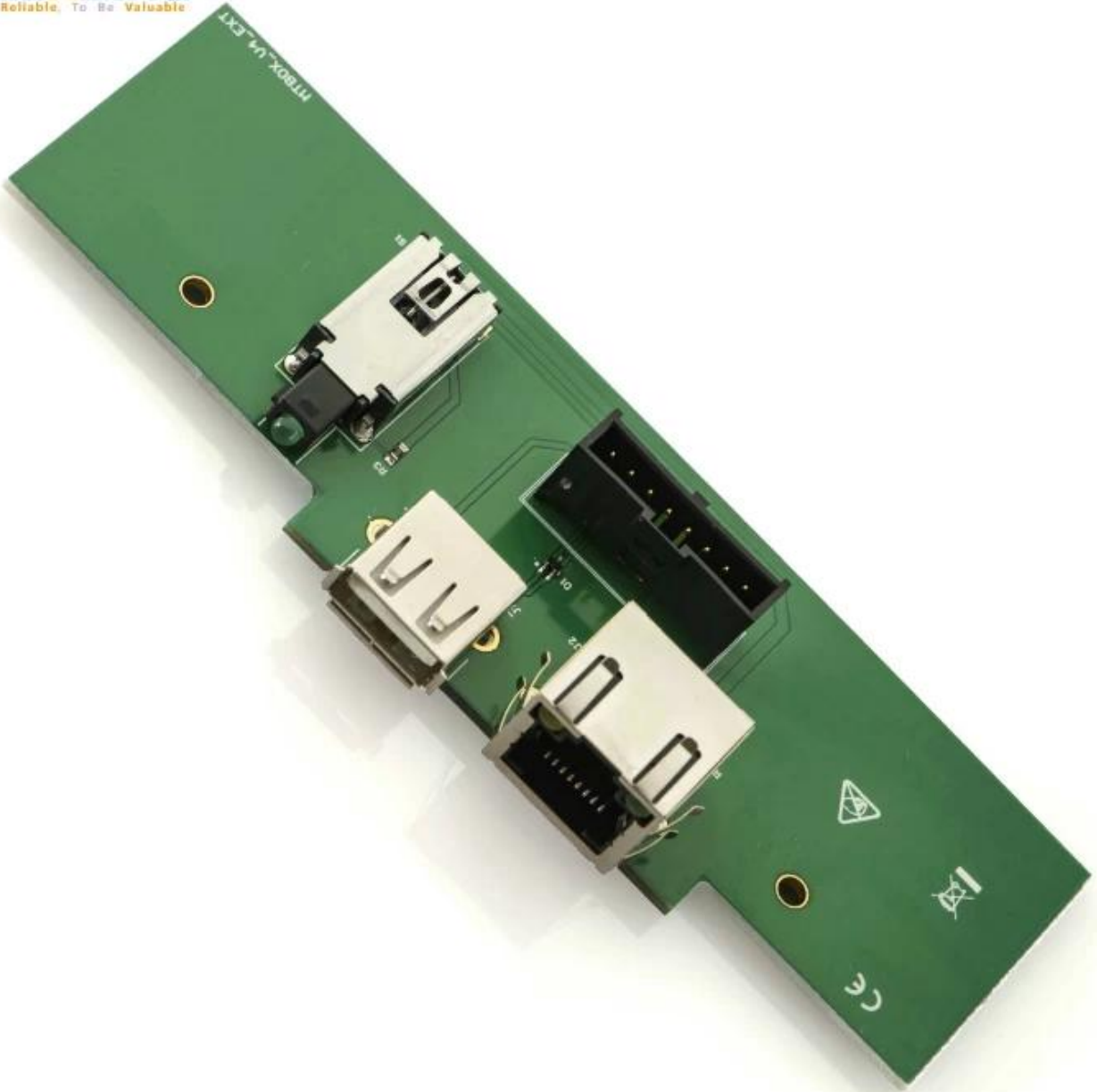


PCBA



PCB







Factory PCB



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine



High-speed flying probe machine



E-test Machine

Factory SMT





CICC INSPECTION CERTIFICATION



嘉泰认证

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No: 18118Q10347R05

We hereby certify that

O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,LIMITED

Credit No: 61691591-000-07-18-7

Registration Add: FLAT/RM 1205 12/F TAI SANG BANK BUILDING 130-132 DES VOEUS ROAD CENTRAL HK

Business Add: 1213, Floor 13, Fortune Building, Danshui Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Has implemented and maintains a **Quality Management System** Which fulfills the requirements of the following standards
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

Scope of certification
Sales of printed circuit boards

Initial issuance period: February 27, 2018
Renewal date: April 22, 2019
This certificate is valid during: April 22, 2019 - February 26, 2021
This certificate is invalid without CICC qualified label in the following period


First supervision and audit	Second supervision and audit	Qualified mark
-----------------------------	------------------------------	----------------

The certificate registration fee ranges from 1,000 to 10,000 RMB. The certificate fee is 1,000 RMB. The certificate is valid for 1 year. The certificate is issued by CICC. The certificate is issued by CICC. The certificate is issued by CICC.






CICC INSPECTION CERTIFICATION



嘉泰认证

质量管理体系认证证书

证书号: 18118Q10347R05

兹证明

诚领供应链(香港)有限公司

统一社会信用代码: 61691591-000-07-18-7
注册地址: 香港中環德輔道中130-132號大生銀行大廈1205室
经营地址: 广东惠州惠阳淡水南亨西路财富大厦13楼1313


建立的质量管理体系符合
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 质量标准适用条款的要求


认证范围
印刷线路板的销售

初次获证日期: 2018年02月27日
换证日期: 2019年04月22日
证书有效期: 自2019年04月22日至2021年02月26日
在下列期限内, 未经CICC黏贴合格标贴, 本证书无效

第一次获证	第二次重审	黏贴处
-------	-------	-----

本证书认证范围不包括未取得有效的国家规定的行政许可、资质许可的产品/服务范围; 本证书通过CICC定期监督审核保持, 与年度《保持认证通知书》共同方为有效; 本证书信息可在国家认监委网站: www.cnca.gov.cn及CICC网站www.cicc.com.cn查询。





Test Report

No. SZXEC1900530401 Date: 30 Mar 2019 Page 1 of 6

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO., LIMITED
1313.FLOOR 13, FORTUNE BUILDING, DANSHUI TOWN, HUIYANG DISTRICT, HUIZHOU, GUANGDONG, CHINA

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the clients as : OSP

SGS Job No. : RP19-006089 - SZ
Date of Sample Received : 22 Mar 2019
Testing Period : 22 Mar 2019 - 30 Mar 2019
Test Requested : Selected test(s) as requested by client.
Test Method : Please refer to next page(s).
Test Results : Please refer to next page(s).

Conclusion : Based on the performed tests on submitted sample(s), the results of Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Polybrominated biphenyls (PBBs), Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and Phthalates such as Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), and Diisobutyl phthalate (DIBP) comply with the limits as set by RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shenzhen Branch

Tina
Tina Fan
Approved Signatory

Red circular seal with Chinese text and SGS logo. Includes disclaimer text in Chinese and English regarding the use of the report and liability.

Member of the SGS Group (SGS SA)



Test Report

No. SZXEC1900530401 Date: 30 Mar 2019 Page 2 of 6

Test Results :

Test Part Description :

Table with 3 columns: Specimen No., SGS Sample ID, Description. Row 1: SN1, SZX19-005304.001, Green"PCB"

Remarks :

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
(2) MDL = Method Detection Limit
(3) ND = Not Detected (< MDL)
(4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method : With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Table with 5 columns: Test Item(s), Limit, Unit, MDL, 027. Lists various substances like Cadmium, Lead, Mercury, Hexavalent Chromium, and various brominated biphenyls with their respective limits and detection methods.

Red circular seal with Chinese text and SGS logo. Includes disclaimer text in Chinese and English regarding the use of the report and liability.

Member of the SGS Group (SGS SA)



ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD

E490354

ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG

Type	Cond Width		Cond Thk mic(mil)	SS/ DS/ DSO	Max	Max		Meets UL796	C		
	Min	Edge			Area Diam	Solder Limits	Oper Temp			Flame	
	mm(in)	mm(in)			mm(in)	C	sec	C	Class	DSR	I
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.											
O-LEADING-401	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-
O-LEADING-407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All	-
Multilayer printed wiring boards.											
O-LEADING-408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:136	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All	*
Single layer printed wiring boards.											
O-LEADING-002	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All	-
O-LEADING-003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-
O-LEADING-033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All	-
O-LEADING-205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-D01	0.14 (0.006)	0.15 (0.006)	33 (1.30)	DS	25.4 (1.0)	260	10	130	V-0	All	*
O-LEADING-S01	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

O-LEADING-S02	0.2 (0.008)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	HB	▲	*
O-LEADING-S03	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL跟踪检验服务的要求。只有带有UL标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.经UL允许从在线认证目录转载“声明必须出现在所摘录材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2019 UL LLC”



PCB 参数		SMT 参数	
层数	1-32	PCB 材料	FR-4, CEM-1, CEM-3, 其他材料
板厚	1 / 3oz-12oz	PCB 尺寸	510x460mm
最小孔径 / 最小间距	3.0mil / 3.0mil	PCB 厚度	50x50mm
最小孔径 / 最小间距	4.0mil / 4.0mil	PCB 厚度	0.5mm-4.5mm
最小孔径	10 : 1	PCB 厚度	0.5-4mm
最小孔径	0.2mm-5.0mm	PCB 厚度	0201
最小孔径 (通孔)	635 * 1500mm	PCB 厚度	0603
最小孔径	4mil	PCB 厚度	15mm
Plated 厚度	+/- 3mil	PCB 厚度	0.3mm
Blind / Buried Vias (All 通孔)	无	PCB 厚度	0.4mm
最小孔径 (通孔, 盲孔)	无	PCB 厚度	+/- 0.03mm
最小孔径	FR-4, FR-4high Tg, 其他材料, 其他材料, 其他材料	PCB 厚度	
最小孔径	HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, 其他材料, 其他材料, 其他材料	PCB 厚度	



Shipping service



Quick Turn Lead Time		
Layer Count:	Lead Tim	Special Requirement
1L/2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

O-LEADING

1. O-Leading 100% 100% 100%?

100% 100% 100% 100% 100%.

1.1 100% ISO 9001 : 2008 100% 100% 100%.

1.2 100% 100% 100% 100% 100%

1.3 100% 100% 100% 100% : 100% 100%, X-ray 100%, AOI (Automated Optical Inspector) 100% ICT (in-circuit testing).

1.4 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.5. 100% 100% 100%

2. O-Leading 100% 100% 100%?

100% 100% 100% (100% : 100%, 100% 100%) 100% 100%, 100% 100% 100% 100%. 100% 100% 100% 100% 31% 100%. 100% 100% 100%.

100% O-Leading 100% 100% 100%. 100% 100%, 100% 100% 100% 100% 100% 100%. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%.

100% 100% 100% 100%. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%.

3. O-Leading 100% 100% 100% 100%?

100% FR4, 100% TG 100% 100% 100%, Rogers, Arlon, Telfon, 100% / 100% 100%, PI 100%

4. PCB 及 PCBA 的製造過程是什麼?

- 4.1 物料清單 BOM (Bill of Materials) : 物料清單, 物料清單表 及 物料清單.
- 4.2 PCB Gerber 檔.
- 4.3 PCB 物料 及 PCBA 物料.
- 4.4 物料清單.
- 4.5 物料清單 及 物料清單 及 物料清單 及 物料清單.

5. PCB 的製造過程是什麼?

物料清單 → 物料清單表 → 物料清單 → 物料清單 AOI → 物料清單 → 物料清單 及 物料清單 → 物料清單 → PTH → 物料清單 → 物料清單 及 物料清單 → 物料清單 → 物料清單 AOI → 物料清單 → 物料清單 及 物料清單 → 物料清單 → 物料清單 → E / T → 物料清單.

6. HDI 的製造過程是什麼?

物料清單 及 物料清單 : 物料清單 及 物料清單, VCP 物料, 物料清單 及 物料清單, LDI 物料清單 及 物料清單 及 物料清單, 物料清單 及 物料清單 Mitsubishi 及 Hitachi 物料, LDI 物料 Screen (Japan) 物料, 物料清單 及 物料清單 Hitachi 物料 及 物料, 物料清單 及 物料清單 及 物料清單 及 物料清單.

7. O-lead 的製造過程是什麼?

O-lead 物料 ENIG, OSP, LF-HASL, 物料 (物料 / 物料), 物料, 物料, 物料, 物料 及 物料, 物料 及 物料 及 物料 及 物料 及 物料. HDI 物料 及 物料 及 物料 OSP, ENIG, OSP + ENIG, BGA PAD 物料 0.3 mm 物料 及 物料 及 物料 OSP OSP + ENIG 物料 及 物料.

8. FPC 的製造過程是什麼? O-Leading 及 SMT 的製造過程是什麼?

O-Leading 物料 8 物料 FPC 物料 及 物料, 物料 及 物料 2000mm * 240mm 物料. 物料 物料 "Flex Capability" 物料 物料. 物料 物料 SMT 物料 物料 物料.

9. PCB 的製造過程是什麼?

- 物料;
- 物料 物料;
- 物料 物料;
- 物料 物料 物料;
- PCB 物料;
- 物料 物料;
- 物料 物料 物料.

10. PCB, PWB 及 FPC 的製造過程是什麼?

PCB 物料 物料 物料 物料. PWB 物料 物料 物料 物料 物料 物料 物料 物料. FPC 物料 Flexible Printed Board 物料.

11. PCB 的製造過程是什麼?

PCB 物料 物料 物料 物料 物料. 物料 Tg 物料 物料 物料. 物料 CTE 物料 物料 物料 物料 物料; 物料 物料 物料 : 物料 PCB 物料 50 物料 250 °C 物料. 物料 物料; 物料 物料 物料 物料 / 物料 物料 物料 PCB 物料. 物料 PCB 物料 物料 物料 物料 物料; 物料 物料 物料 物料 物料 物料 物料 物料.

12. O-leading 的 PCB 的製造過程是什麼?

O-leading 物料 物料 PCB 物料 FPC 物料 PCB 物料 物料 物料 物料 物料 物料 物料. 物料 物料 物料 物料 物料 物料 物料 物料 物料 物料 物料 物料.

13. 物料 物料 物料 物料?

□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□, SI6000 soft □ POLAR INSTRUMENTS□ CITS 500s □□□□ □□□□□□.
□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□.